



Таблица 1

Условное обозначение отб.	Диаметр отб., мм	Диаметр контактной площадки, мм	Наличие металлизации	Кол. отб.
⊕	0,8±0,05	1,6	Да	41
⊕	1±0,05	1,6	Да	24
⊕	1,2±0,05	2,5	Да	6
⊕	1,5±0,05	2,6	Да	18
⊕	2,4 ^{+0,25}	3,0	Да	2
⊕	2,8 ^{+0,25}	-	Да	4

- Общие допуски формы и расположения - 30893.2-2002 - Н.
- Шаг координатной сетки 0,25мм ГОСТ Р 51040-97
- Плату изготовить комбинированным позитивным методом.
- Класс точности платы по ГОСТ Р 53429-2009 - 2.
- Параметры отверстий платы приведены в таблице 1.
- Плата должна соответствовать ГОСТ 23752-79, группа жесткости - 1.
- Финишное покрытие металлизированных поверхностей меди по ГОСТ 9.301-86 толщиной не более 500нм флюсом ЛТИ-120 ГОСТ 19250-73 и припоем ПОС-61 ГОСТ 21930-76.
- Контроль функциональный ручным методом по ГОСТ 23752.1-92.
- Остальные технические требования по ОСТ 4 ГО.070.014-75.

				ИУ4.11.03.03.21.7.314.002			
				УМЗЧ на биполярных транзисторах Плата печатная			
Изм/Лист	№ докум	Подп	Дата	Лит	Масса	Масштаб	
Разраб	Кружков В.С.					2:1	
Пров	Селиванов К.В.						
Т.контр				Лист	Листов 1		
Н.контр				МГТУ им. Н.Э.Баумана Кафедра ИУ4 Группа ИУ4-735			
Утв							
				Стеклотекстолит FR4-T д35 IPC-4101/21			
				Формат А2			